

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局



(10) 国际公布号
WO 2024/125018 A1

(43) 国际公布日
2024 年 6 月 20 日 (20.06.2024)

(51) 国际专利分类号:
B26F 1/44 (2006.01) **B26D 7/26** (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2023/119772

(22) 国际申请日: 2023 年 9 月 19 日 (19.09.2023)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202223362489.6 2022 年 12 月 14 日 (14.12.2022) CN

(71) 申请人: 深圳市领略数控设备有限公司 (SHENZHEN LLMACHINE CO., LTD.) [CN/CN];
中国广东省深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道 102 号旭日厂厂房 32 栋 101 房, Guangdong 518118 (CN)。

(72) 发明人: 刘仁举 (LIU, Renju); 中国广东省深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道 102 号旭日厂厂房 32 栋 101 房, Guangdong 518118 (CN)。米晓云 (MI, Xiaoyun); 中国广东省深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道 102 号旭日厂厂房 32 栋 101 房, Guangdong 518118 (CN)。周军 (ZHOU, Jun); 中国广东省深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道 102 号旭日厂厂房 32 栋 101 房, Guangdong 518118 (CN)。

(74) 代理人: 广州嘉权专利商标事务所有限公司 (JIAQUAN IP LAW); 中国广东省广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 A 栋 910, Guangdong 510627 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,

(54) Title: DIE FRAME

(54) 发明名称: 模架

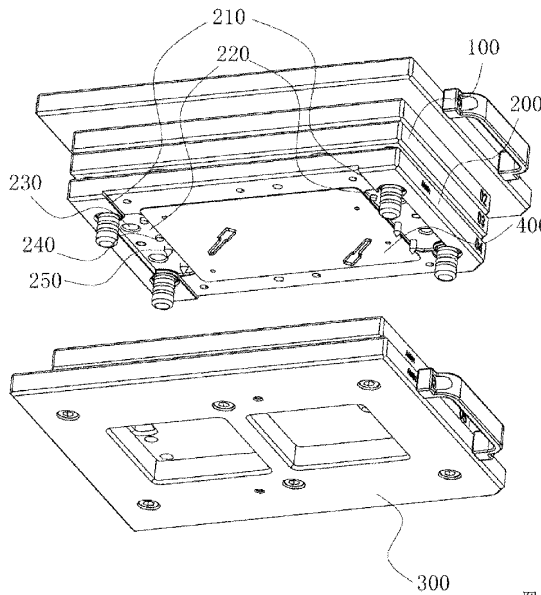


图 1

(57) Abstract: The present application discloses a die frame, comprising: an upper die base, an upper pressing plate, and a lower die base. The upper pressing plate is connected to the bottom of the upper die base, and a lower end surface of the upper pressing plate is used for mounting an etching die. The lower die base is correspondingly arranged below the upper die base and used for bearing materials. A raised portion is provided on the lower end surface of the upper pressing plate or an upper end surface of the lower die base, and the thickness of the raised portion is greater than the thickness of the etching die, so that an uncut height is reserved between

[见续页]

WO 2024/125018 A1

BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

根据细则4.17的声明:
— 发明人资格(细则4.17(iv))

本国际公布:
— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

the etching die and the lower die base during die closing, and the uncut height is equal to a thickness difference between the raised portion and the etching die. The die frame in the present application can ensure that the materials are not overcut, and the service life of the etching die can be prolonged.

(57) 摘要: 本申请公开了一种模架, 包括: 上模座、上压板以及下模座; 上压板连接于上模座底部, 上压板的下端面用于安装蚀刻模; 下模座对应设于上模座的下方, 用于承载物料; 其中, 上压板下端面或下模座上端面设有凸台, 凸台的厚度大于蚀刻模的厚度, 以使合模时, 蚀刻模和下模座之间留有未切高度, 未切高度等于凸台和蚀刻膜的厚度差。本申请的模架能够确保物料不会被过切, 也能够延长蚀刻模的使用寿命。